

# 2025.02.19 CEPC ITK module meeting

---

Indico: <https://indico.ihep.ac.cn/event/25110/>

参会: 李一鸣, 王聪聪, 严琪, 李刚, 项治宇, 徐子骏, 姜啸捷, 曾程, 李宇杰, 崔宇鑫

主持&记录: 李一鸣

## 介绍会议背景

---

- Ref-TDR主要内容完成, 今年精力将转向研发工作。
  - 过去几年ITK研发集中在CMOS芯片, 有定期会议, 里程碑和可交付物较明确
  - 为推进ITK模块和系统预研, 计划定期召开会议, 今天是首次。初定隔周三下午。
- 关注问题:
  - 最紧迫的是dummy module制作, 最好能在六月Ref-TDR发布前补充相关内容
  - 其他包括模块设计, 机械, 生产过程等
- 与其他项目的协同:
  - AMS L0模块生产结束, 人员、设备可参与CEPC工作, 积累了大量经验
  - 与LHCb升级项目可形成资源共享

## Dummy module 准备

---

- 目的: 在实际全尺寸芯片实现前, 模块研发第一步
- 任务分工:
  - 整体设计和组装过程 (一鸣、煦昊, all)
  - dummy sensor (聪聪): 设计已交付, 预期三个月完成。考虑调研玻璃、塑料等其他材质作为dummy (来源, 报价)?
  - 电子学部件 (子骏, 需与雄波和电子学组紧密沟通): flex, power cable, dummy chip, ...
  - 机械 (+冷却?) (宇杰+湖大同事, IHEP机械组同事未来有望加入) 碳纤维布/毡/泡沫, 桁架结构, 冷却管 (尼龙材料、钛管) ...

## ITK 预算划分

---

- 列出ITK预算组成部分 (见幻灯片)